

产品概要

雅拓莱免洗无铅锡膏

产品名称

#233 -无铅锡膏 - Sn42/Bi58

产品编号

EMCO#233-302P

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

DOC CATEGORY: 3

PF - EMCO#233-302P - 04122014 - REV.D - Chinese - Page 1 of 5



. China . Malaysia . Singapore

产品描述

雅拓莱的EMCO#233-302P 无铅低温锡膏是特殊设计的松香型锡膏，用于无铅焊接操作。这种锡膏可提供优良的可重复性和一致性，以及在低温应用上异常的湿润能力。

特征：

- 探针可测试的残留物
- 依据 IPC J-STD-004 标准 ROL1
- 优良的抗坍塌性
- 优良的粘着表现和可印刷时间
- 延长的印刷停歇时间
- 光亮，无色的残留物

合金的化学成份

雅拓莱的 EMCO#233-302P 无铅锡线的成份被严格控制在以下 LF-302 规格： -

元素		含量(%wt/wt)
锡	Sn	41.0-43.0
铅	Pb	Max 0.050
铝	Al	Max 0.005
锑	Sb	Max 0.050
砷	As	Max 0.030
铋	Bi	余数
铜	Cu	Max 0.080
铁	Fe	Max 0.010
锌	Zn	Max 0.003
镉	Cd	Max 0.002
银	Ag	Max 0.050
镍	Ni	Max 0.010
铟	In	Max 0.050
金	Au	Max 0.050

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

产品外观

雅拓莱的锡膏呈现为灰色的均匀的锡膏。

锡粉颗粒

焊料颗粒的大小依据国际标准规格 IPC J-STD-005。

按样品中重量百分比%	标称尺寸 3	标称尺寸 4
少于 1%的样品尺寸大于	45 微米	38 微米
最少 80%的样品介于	45-25 微米	38-20 微米
最多 10%的样品小于	20 微米	20 微米

EMCO#233-302P 无铅锡膏特性(25-45µm)

检测项目	特性	检测方法
粘度	150,000 ± 30,000 cp	PCU-203, 10rpm, 25°C
助焊剂活性 (依据 IPC J-STD-004)	ROL1	IPC J-STD-004
铜板腐蚀试验	合格	IPC J-STD-004
助焊剂含量	9.5 ± 0.5%	JIS Z 3197
润湿性试验	合格	IPC J-STD-005
锡珠试验	合格	IPC J-STD-005
坍塌试验	合格(10 分钟 @ 150°C)	IPC J-STD-005
表面绝缘阻抗(典型的), 168 小时(Ω)	合格 (≥1 x 10 ⁹ Ω)	IPC J-STD-004

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

检测项目和结果

印刷

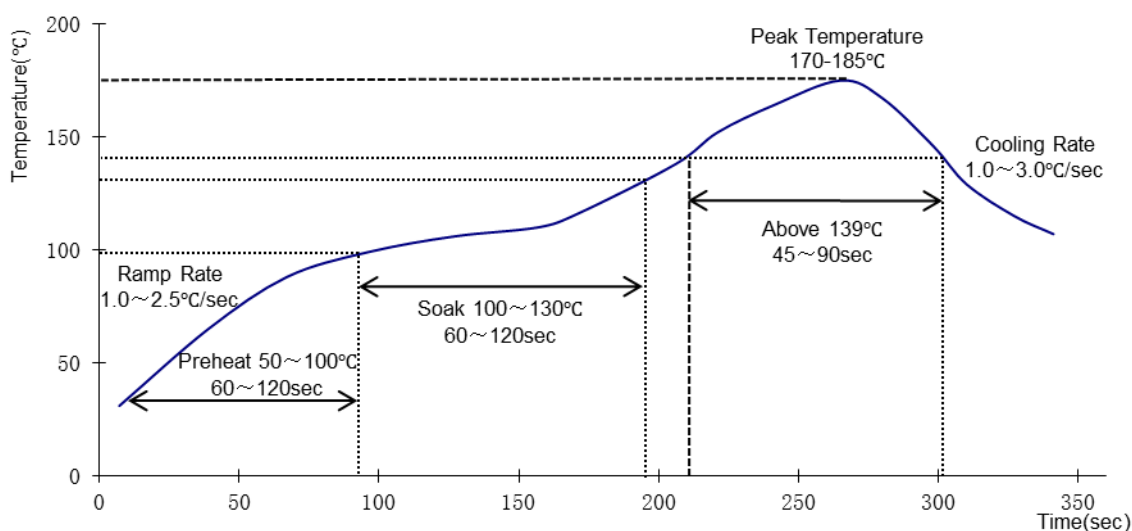
模板材料	不锈钢	
模板的厚度	周节	模板的厚度
	0.3-0.5 毫米	0.100-0.150 毫米
	0.635 毫米	0.150-0.200 毫米

刮刀 建议使用不锈钢刮刀。
刮刀压力 0.16-0.34 公斤/平方厘米刮刀长度取决于印刷速度。较高的印刷速度需要较高的刮刀压力。

刮刀速度 25-100 毫米/秒

贴辊 保持贴辊直径为 15-20 毫米。

EMCO#233-302P 无铅锡膏回流焊温度曲线图



预热

以 1-2.5°C/s 的速度从室温加热到 90-100°C。更快的速度会因蒸发吸附的湿气而造成元件的破裂。

均热处理区

介于 100 和 130°C。均热处理区用于使 PCB 板上的温度差异变水平。经常用于红外线炉与元件和铜料分布带有较大差异的 PCB 板。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

提速至回流

最大 2.5°C/s，因为元件内部不同的热膨胀率。

回流

峰值温度与元件规格有关。在 5-6 秒时峰值温度介于 170-185°C，45-90 秒高于 130°C。

冷却

最大 2.5°C/s，因为元件内部不同的热膨胀率。

清洗

印错 可用与市售的溶剂清洁剂擦拭

清洗后 EMCO#233-302P 残渣可留在电路板上回流。如果需要清洗，可使用市售的溶剂清洁剂。

模板清洗 建议使用市售的丝网清洗剂蜡纸擦拭。

包装

每罐锡膏重约 500 克，应严格密封。标贴上应附有产品编号、合金成份、颗粒尺寸、净重和产品批号等相关信息。锡膏罐应置于泡沫盒内，且包装在硬纸盒里，每盒重量约为 10 公斤。可要求 600 或 1000 克的卡头式型锡膏。

贮存和保质期

请存放在 3-10°C 以下。锡膏有效期限自生产日期开始六个月内。锡膏使用之前，需要回温大约 4 小时后才能使用。在把锡膏放到模板前，可用匙搅拌锡膏为 1-2 分钟或锡膏搅拌机为 30-60 秒。

出货

出货同时附上分析证明书。

材料安全数据单

产品的 MSDS/ SDS 可向销售部索取。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用